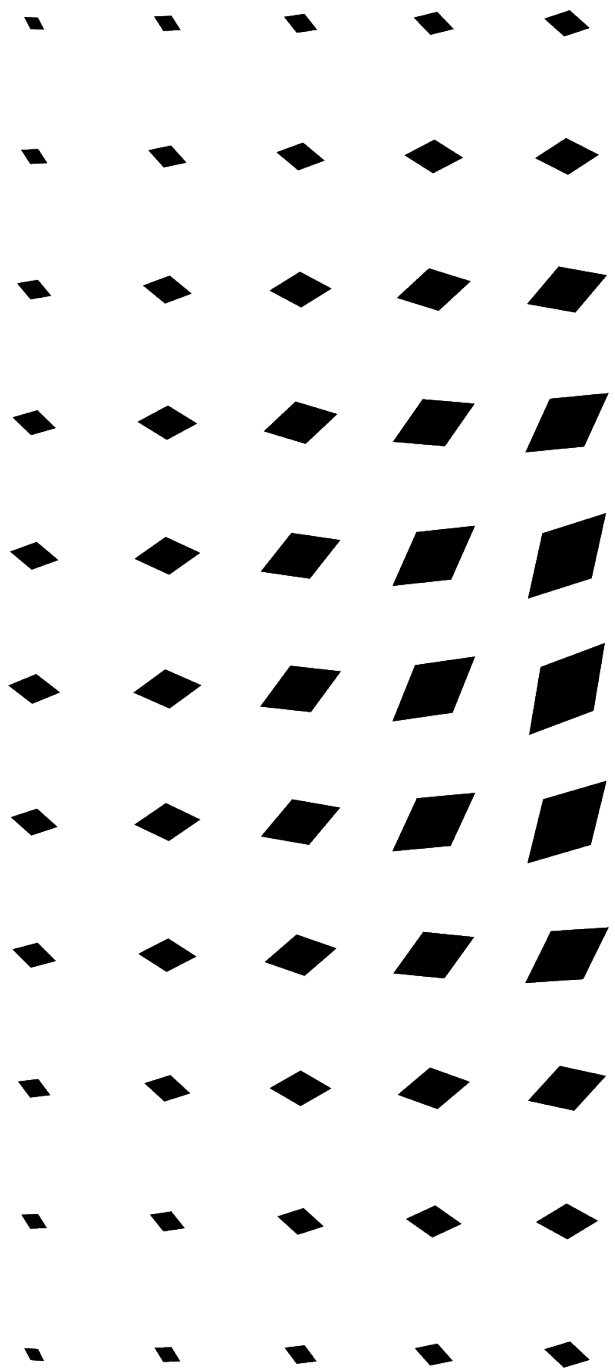


SiC MOSFET芯片使用指南



SiC MOSFET芯片使用指南

不当的运输、储存或组装可能会导致芯片可靠性降低甚至损坏。
自三菱电机发货后，在完成封装和最终检验之前，应在每个工艺环节中妥善处理晶圆与芯片。

三菱电机发货之后

运输	■ 如果不遵守以下注意事项，可能会导致芯片损坏、逆变器故障或设备失效。 • 请务必按照规定的方向搬运运输纸箱。 • 请勿抛掷、摔落纸箱或使纸箱受到机械冲击。 • 请勿让纸箱受潮。
----	---



储存	■ 若未遵守以下注意事项，可能会导致组装缺陷或模块性能及可靠性下降。 • 请妥善储存产品，防止受潮、振动和机械冲击。 • 请在适当的环境条件下储存产品。 • 推荐储存条件：$5^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 30^{\circ}\text{C}$, $45\% \leq \text{RH} \leq 70\%$ • 包装打开后，应将产品存储在氮气环境中，并尽快使用。 • 对于超过规定存储期限的芯片，客户应进行充分的质量验证，并判断其是否适合使用。 • 请勿使用易积聚静电的容器运输或储存。
----	---



返回仓库	
组装&检验	■ 如不遵守以下注意事项，可能导致严重事故。 • 请勿将芯片、组装好的模块或逆变器置于高湿度环境（包括凝结环境）、有机溶剂、腐蚀性气体、爆炸性气体、颗粒污染物或腐蚀性物质中。 ■ 如果不遵守以下注意事项，可能会因人员或带电包装材料产生的静电放电（ESD），或因芯片引脚间施加过高电压，导致芯片或模块受损。 • 切勿用裸手触摸芯片或模块的引脚。 • 在模块组装过程中，所有设备和人员均应接地。 • 采取静电放电（ESD）控制措施，例如在工作台及周围地面铺设导电垫。 • 若芯片或模块带电，应立即进行放电。 • 当栅极与源极引脚处于开路状态时，切勿在源极与漏极之间施加电压。



以模块形式转入下一工序

